

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













産業用デバイスの信頼性の高い USB データインターフェース。多くの利点から、電気業界では USB ソケットが最も使用されています。

USB Type-A、B、C、マイクロ USB の広範なポートフォリオにより、将来性のある最大 10 Gbit/s の高速デバイス設計が可能です。USB PCB ソケットは、堅牢な規格である USB 2.0、3.0、3.1 に対応しており、高速かつ簡単なデータ転送を実現します。

個々のコネクタは高い耐久性といった要件を満たし、信 頼性の高い接続技術を提供します。

- 最大10.000回のプラグサイクル
- THT、THRまたはSMDのはんだ付け工程に対応
- 180° (垂直 / 縦型) または 90° (水平 / 横型) の種別をご 利用いただけます
- ボックス (BX) またはロール (テープオンリール、RL) に 梱包
- 強化金層による防食性の向上
- 10 Gbit/sのデータ転送に対応したUSB 3.1 ソケットが 高速データ転送を実現
- USB Type-C ソケットは対称的な形状のため差し込み時 の間違いがありません
- 安定したプラグ アンド プレイ操作 システムをシャットダウンまたは再起動せずに接続と切断可能

一般注文データ

パージョン	データの最小化 – USBジャック, メス型ヘッダー, 480 Mbps, SMDはんだ接続, 90°, ≥ 1500, ピッチ (mm) (P): 2.00 mm, 極数: 4, LCP, 黒色, トレイ(手 動式アセンブリ)
注文番号	<u>2563720000</u>
種別	USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572339
数量	100 Stück
パッケージ	トレイ(手動式アセンブリ)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	14 mm	奥行き(インチ)	0.551 inch
高さ	11.22 mm	 高さ(インチ)	0.442 inch
下位バージョンの高さ	7.12 mm	 幅	14.5 mm
幅(インチ)	0.571 inch	 正味重量	0.001 g

システム仕様

LED	いいえ	PCB の取り付け	SMDはんだ接続
はんだピン位置の公差	0.1 mm	はんだピン寸法	八角形
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動	シールド	
	はんだ付け		はい
シールドタブ	なし	シールド材質	真鍮
シールド面	ニッケルメッキ	ソルダーピン長 (I)	1.4 mm
ピッチ (mm) (P)	2 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.079 "
プラギング回数	≥ 1500		IP20
外向きエルボ	90°	差し込み力 / 極、最大.	35 N
引張強度/極、最大.	10 N	性能カテゴリ	480 Mbps
接続方式	ソケットコネクタ	極当たりソルダーピン数	1
極数		製品ファミリー	データの最小化 – USB
	4		ジャック
転送速度	480 Mbps		

電気プロパティ

定格電圧	30 V	定格電流	1.5 A	
絶縁耐性	≥ 1000 MΩ	 耐電圧、接点 / 接点	750 V AC	

材料データ

絶縁材	LCP		
カラーチャート(類似)	RAL 9011	 絶縁材グループ	II
比較追跡指数(CTI)	≥ 500	絶縁耐性	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅		
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	3080 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	60 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

梱包

パッケージ	トレイ(手動式アセンブ	VPE 長	
	ý)		261 mm
VPE幅	207 mm	VPEの高さ	16 mm

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
ダウンロード	
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20211223 USB 2.0A - Änderung Schirmblech 20211223 USB 2.0A - Change of shielding design
カタログ	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

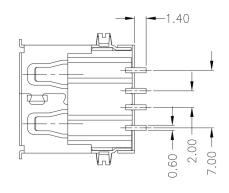
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

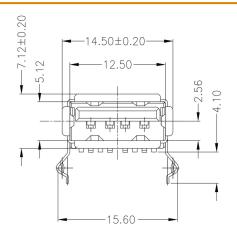
寸法図

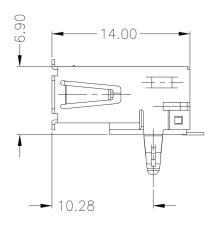




寸法図

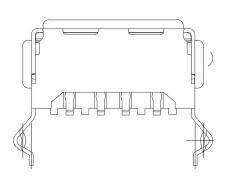
寸法図

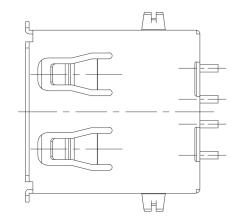




寸法図

寸法図







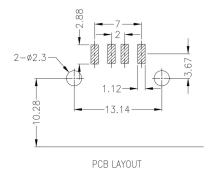
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

PCB設計





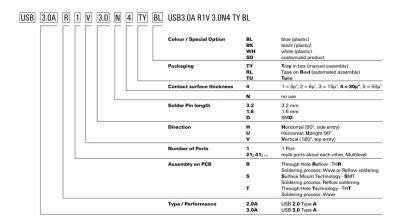
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

凡例



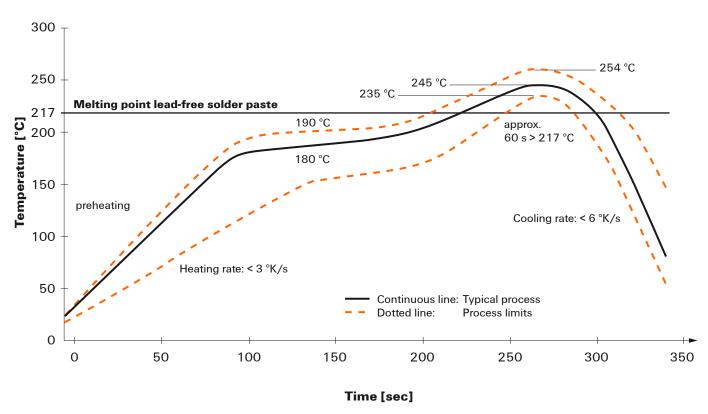


Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- · Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated′. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at \geq -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.